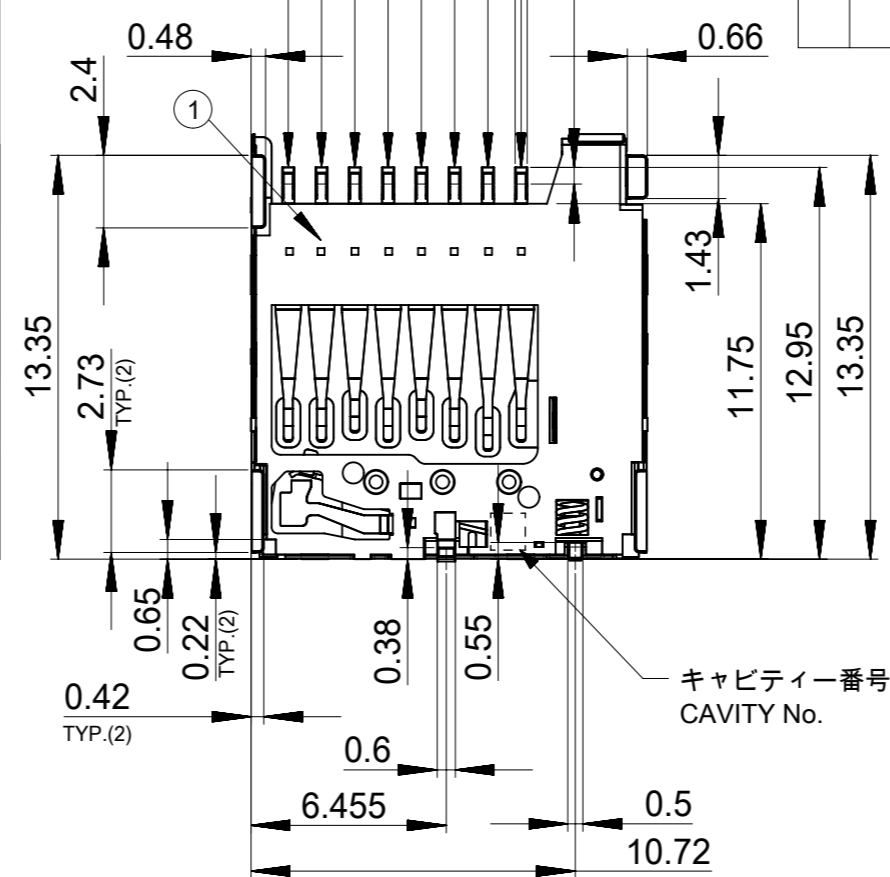


- Pin No.1: DAT2
- Pin No.2: CD/DAT3²
- Pin No.3: CMD
- Pin No.4: V DD
- Pin No.5: CLK
- Pin No.6: V ss
- Pin No.7: DAT0
- Pin No.8: DAT1

社名
COMPANY NAME
(0.48)
(WITHOUT SEAL OF CARD)

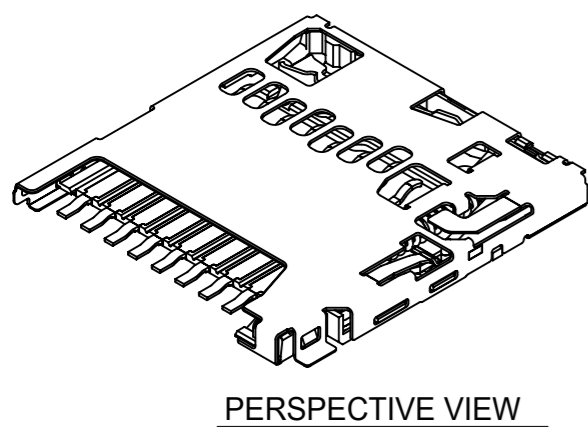


番号 NO.	名称 NAME	材料 MATERIAL	仕上げ(めっき) FINISHES (PLATING)
①	ハウジング HOUSING	液晶ポリマー(LCP)、ガラス充填、UL94V-0、黒 LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP), GLASS FILLED, UL94 V-0, BLACK	
②	カムスライダー CAM SLIDER	液晶ポリマー、(LCP)、ガラス充填、UL94V-0、黒 LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP), GLASS FILLED, UL94 V-0, BLACK	
③	ターミナル TERMINAL	燐青銅 PHOSPOHR BRONZE	接触部: 金めっき (0.5μm MIN.) テール部: 錫めっき (2.0μm MIN.) 下地: ニッケルめっき (1.0μm MIN.) CONTACT AREA : GOLD PLATING (0.5 MICROMETER MINIMUM.) SOLDER TAIL AREA : TIN PLATING (2.0 MICROMETER MINIMUM.) UNDERPLATE : NICKEL OVERALL (1.0 MICROMETER MINIMUM.)
④	シェル SHELL	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL	ステンレス鋼 基板実装部: 金めっき 下地: ニッケルめっき NAIL AREA : GOLD PLATING UNDERPLATE : NICKEL OVERALL
⑤	スプリング SPRING	ピアノ線 SWP	全面: ニッケルめっき NICKEL OVERALL
⑥	ピン PIN	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL	
⑦	ディテクトレバー DETECT LEVER	燐青銅 PHOSPOHR BRONZE	接触部: 金めっき (0.2μm MIN.) 基板実装部: 金めっき 下地: ニッケルめっき CONTACT AREA : GOLD PLATING (0.2 MICROMETER MINIMUM.) NAIL AREA : GOLD PLATING UNDERPLATE : NICKEL OVERALL
⑧	ディテクトスイッチ DETECT SWITCH	燐青銅 PHOSPOHR BRONZE	接触部: 金めっき (0.2μm MIN.) 基板実装部: 金めっき 下地: ニッケルめっき CONTACT AREA : GOLD PLATING (0.2 MICROMETER MINIMUM.) NAIL AREA : GOLD PLATING UNDERPLATE : NICKEL OVERALL

NOTES

1. ターミナル及びネイルの平坦度は0.1MAX (測定用定板面を基準)
TERMINAL AND NAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAX.(FROM GAUGE PLANE)
 2. スタンドオフ寸法 STAND OFF
 3. パターン禁止エリア PATTERN PROHIBITION AREA
 4. カード検知スイッチ DETECT SWITCH
- | | | | |
|---------|-------------------------|------|-------|
| カード挿入時 | CARD INSERTING POSITION | クローズ | CLOSE |
| カード未挿入時 | NO CARD | オープン | OPEN |
5. 肉抜き位置は任意とする。CAVITY IS TO BE OPTIONAL.
 6. ロット印字は任意とする。LOT NUMBERING IS TO BE OPTIONAL.
 7. GND推奨パターン GND RECOMMENDED PATTERN.
 8. ELV及びRoHS適合品 ELV AND RoHS COMPLIANT.
 9. カード裏挿し誤挿入時、カード突出エリア (他の部品の設置、非推奨範囲)
WHEN A CARD IS MISS-MATED IN THE REVERSE ORIENTATION,PART OF THE CARD PROTRUDES FROM THE SHELL DUE TOTHE CARD-MISS MATING PREVENTION FEATURE. THEREFORE, NO COMPONENTS ARE ALLOWED TO BE PLACED IN THIS AREA.

503398-0891		8
EMBOSSED PACKAGE		
オーダー番号	ORDER NO.	極数 CIRCUITS
CONNECTOR SERIES No. 503398-0811		



10. GENERAL TOLERANCES
10UNDER ±0.2
10OVER 30 UNDER ±0.25
30OVER ±0.3

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REVISED EC NO: 168584 DRWN: ESATO CHK'D: KTAKAHASHI APPR: NUKITA	2017/11/22	2017/12/05	2017/12/05	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	DIMENSION UNITS MM	SCALE 4:1	DRWN BY YMATSUMOTO	DATE 2009/09/17	CHK'D BY MTOMITA	DATE 2009/09/17	APPR BY NUKITA	DATE 2009/09/17	DRAWING SIZE A3	THIRD ANGLE PROJECTION	<p>MICRO SD CONN. PUSH/PUSH & NORMAL SUPER-SMALL TYPE</p> <p>PRODUCT CUSTOMER DRAWING</p>						
	4 PLACES	± 0.2																			
	3 PLACES	± 0.25																			
	2 PLACES	± 0.3																			
1 PLACE	± 0.1																				
				DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS											SERIES 503398	MATERIAL NUMBER	CUSTOMER GENERAL MARKET	DOCUMENT NUMBER SD-503398-001	DOC TYPE PSD	DOC PART 001	SHEET NUMBER 1 OF 2

